江苏	图	图-	号: 314BD003 版本 A.O							
贴片方向(芯片与片环方向示意图) 框架		传输进料方向	—							
第一		个孔为椭圆孔/								
X17			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	备	r注及特殊	殊要求(Ren	mark&Speci	ial Instructi	on)	
1 1 7 VDD										
顶针	点胶方式									
单顶针 多顶针	点胶	画胶 /						/ 	<u> </u>	
产品型号 (Product Type):	HS2353-P		线材直径 (Wire Diameter):	银合金线0.8mil		芯片减薄厚度 (Chip thinning thickness)		220±10um		
芯片名称 (Die Name):	HS5122		压焊点尺寸 (Pad Opening):	50. 35×50.		装片胶	首选	9246LB5(导电胶		电胶)
芯片尺寸: (Die Size):	0.5548×0.4332mm		最小压焊间距 (Min Pitch):	59.85um		(Epoxy)	备选	S6100	(导电周	交)
封装形式 (Package Type):	SOP14(8.65X3.9X1.4 e=1.27)		先焊线 (Wire Bond Start):	PIN11		塑封料 (Molding	首选	GR710)GN	
引线框 (Lead Frame):			焊线总数 (Quantity of Wire):	16		Compound)	备选	/		
L/F电镀方式 (L/F Plating Type):	雾 锡		最长线长(Length of longest Wire):	1.61mm	CUP.		OAC	YES		NO O
晶圆尺寸 (Wafer Size):	/		顶层铝厚 (Top Al Thickness):	1um(3层)		RF 芯片		YES		NO .
吸嘴 (suction nozzle)	RR10×10		切割道(Cutting Way)	60um	60um		LOW-K芯片			NO
拟制 Prepared by	钱培丽 2022.7.13		审核 Checked by			批准 Approved by				